



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Настольная система автоматической 2D/3D инспекции печатных плат MV-3 OMNI



Идеальное сочетание самых совершенных инструментов 2D и 3D инспекции теперь доступно и в настольном исполнении.

Камера сверхвысокого разрешения (до 25 Мп) с телецентрической линзой 7,7 мкм и восьмиуровневой цветной системой подсветки дает детальное изображение компонентов типоразмера 01005 (и даже меньше!). Боковые камеры разрешением 10 или 18 Мп дополняют инспекцию возможностью обзора компонента с четырех сторон. Видеоинтерфейс CoaXPress передает изображение со скоростью 25 Гб/с, позволяя обрабатывать до 120 кадров в секунду, тем самым обеспечивая максимальную эффективность и производительность. Предметом 2D инспекции является точность монтажа (отсутствие смещений и правильная ориентация по ключу), определение номинала компонента по цвету или маркировке (применяется оптическое распознавание символов), наличие повреждений или инородных объектов вблизи компонента, качество пайки (в том числе, ТНТ-компонентов и «безвыводных» компонентов типа QFN или PLCC).

Запатентованная система MIRTEC OMNI-VISION® 3D осуществляет инспекцию с помощью четырёх цифровых проекторов, работающих на 2-х частотах, предоставляя подробную объемную модель объекта инспекции для анализа его высоты и объема. 3D достоверно выявляет поднятые или некомпланарные компоненты и их выводы и измеряет параметры паяного соединения (форма, объем, высота затекания припоя) для 100% контроля недостаточной/избыточной пайки.



Бесплатные консультации
для наших заказчиков:

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технические характеристики

Параметры		MV-3 OMNI	
Размеры печатной платы (мин / макс)		50×50 / 450×390 мм	
Технология инспекции OMNI-VISION® 3D/2D			
Технология 3D-инспекции		4 (опционально 8) цифровых проекций Moiré	
Точность измерения высоты		± 3 мкм	
Максимальная скорость инспекции 3D/2D			
Камера 25 Мп	Линза 7,7 мкм	1 460 мм ² /с	
Камера 15 Мп	Линза 10 мкм	1 890 мм ² /с	
	Линза 15 мкм	4 260 мм ² /с	
Максимальная скорость 2D инспекции			
Камера 25 Мп	Линза 7,7 мкм	4 593 мм ² /с	
Камера 15 Мп	Линза 10 мкм	5 080 мм ² /с	
	Линза 15 мкм	10 716 мм ² /с	
Спецификация системы			
Система подсветки		8-канальная цветная	
Система боковых камер [опция]		Цветные цифровые боковые камеры 10 или 18 Мп (4 шт.)	
Программное обеспечение	Стандартная комплектация	Встроенный анализ статистики (SPC), ПО для участка ремонта, отладчик	
	Опция	RRS, IRS, OLTT, SPC Server, ePM-AOI (подробности по запросу)	
Толщина платы	Стандартная комплектация	0,5 мм - 3 мм	
	Опция	0,5 мм - 5 мм	
Минимальный размер объекта инспекции	Камера 25 Мп	Линза 7,7 мкм	Чип 0201 (мм) / Чип 008004 (дюйм) / шаг выводов ИС 0,3 мм
	Камера 15 МП	Линза 10 мкм	Чип 03015 (мм) / Чип 01005 (дюйм) / шаг выводов ИС 0,3 мм
		Линза 15 мкм	Чип 0603 (мм) / Чип 0201 (дюйм) / шаг выводов ИС 0,4 мм
Электропитание		200-240 В, 1 фаза, 50~60 Гц, 1,1 кВт	
Габариты и вес (включая рабочий стол)			
Габариты		1,005 x 1,200 x 1,520 мм	
Вес		~350 кг	

ООО «ЛионТех»
mail@liontech.ru



Бесплатные консультации
для наших заказчиков:

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru